

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 重要在研项目取得阶段性成果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 在研项目取得阶段性成果情况

在研项目名称：数字助听器芯片研发

公司于2020年8月设立子公司湖南芯海聆半导体有限公司（以下简称“芯海聆”），主要进行数字助听器芯片（以下简称“芯片”）的研发及相关算法开发。2021年2月至5月，芯海聆自主研发芯片取得重大进展，首次完成多项目晶圆（简称“MPW”），随后MPW样片经过封装测试并在公司数字助听器产品中进行开发应用与验证。

2021年10月，芯海聆开发完成的芯片交由代工厂进行生产排期，准备量产工作。2022年3月8日，芯海聆自主研发芯片成功量产，并已收到代工厂交付的首批量产芯片。

### 二、 对公司的影响

#### （一） 对公司财务状况和经营成果的影响

芯海聆自主研发芯片的成功量产，将有助于加快公司数字助听器的研发工作，降低公司产品对外部芯片的依赖程度，提高公司数字助听器的技术水平，逐步降低公司数字助听器的生产成本，提升公司产品的市场竞争力和盈利水平。

### 三、 风险提示

在研项目可能存在如下风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险：

#### （一） 其他影响

芯海聆自主研发芯片能否按计划投入使用还受多方因素的影响，依然存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，

及时履行信息披露义务。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日